

昇陽半導體2025年第3季法說會

2025年 11月

Safe Harbor Notice

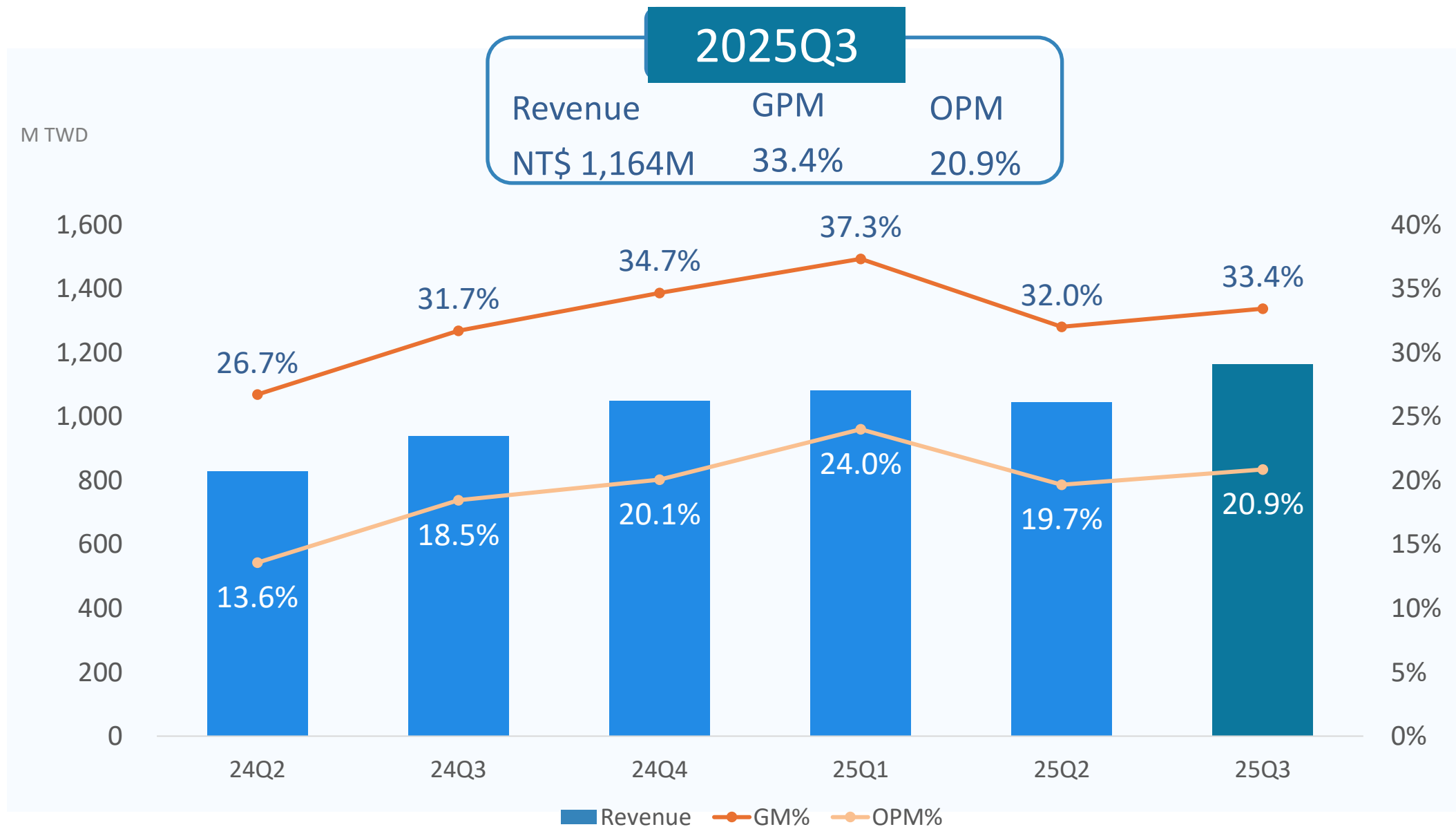
- 昇陽半導體對其目前期望的陳述是前瞻性陳述，受到重大風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的內容有重大差異。
- 有關可能導致實際結果變化的因素的資訊，可在昇陽半導體向台灣證券交易所公司（TWSE）提交的年度或季度報告以及PSI不時向TWSE提交的其他文件中找到。
- 除非法律有要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因。
- 此份報告的數字是按照國際財務報導準則（IFRS）編制的。

Agenda

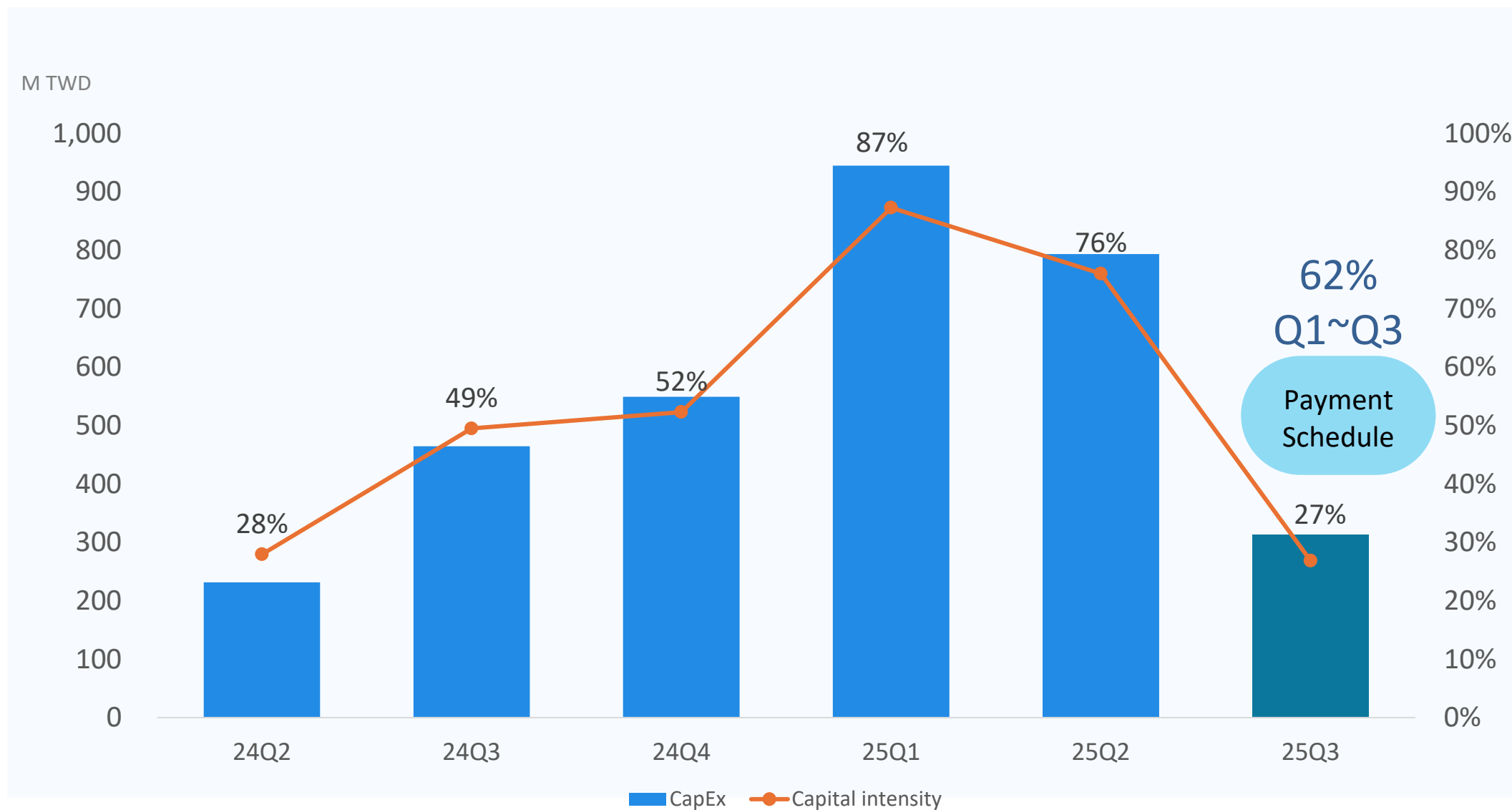
- 第3季財務表現
- 半導體產業展望
- 再生晶圓成長動力以及市佔率預估
- 12 吋矽晶圓薄化業務的潛在成長動能
- 長期擴產計劃
- 核心訊息

第3季財務表現

財務表現



依市場需求 即時回應客戶所需

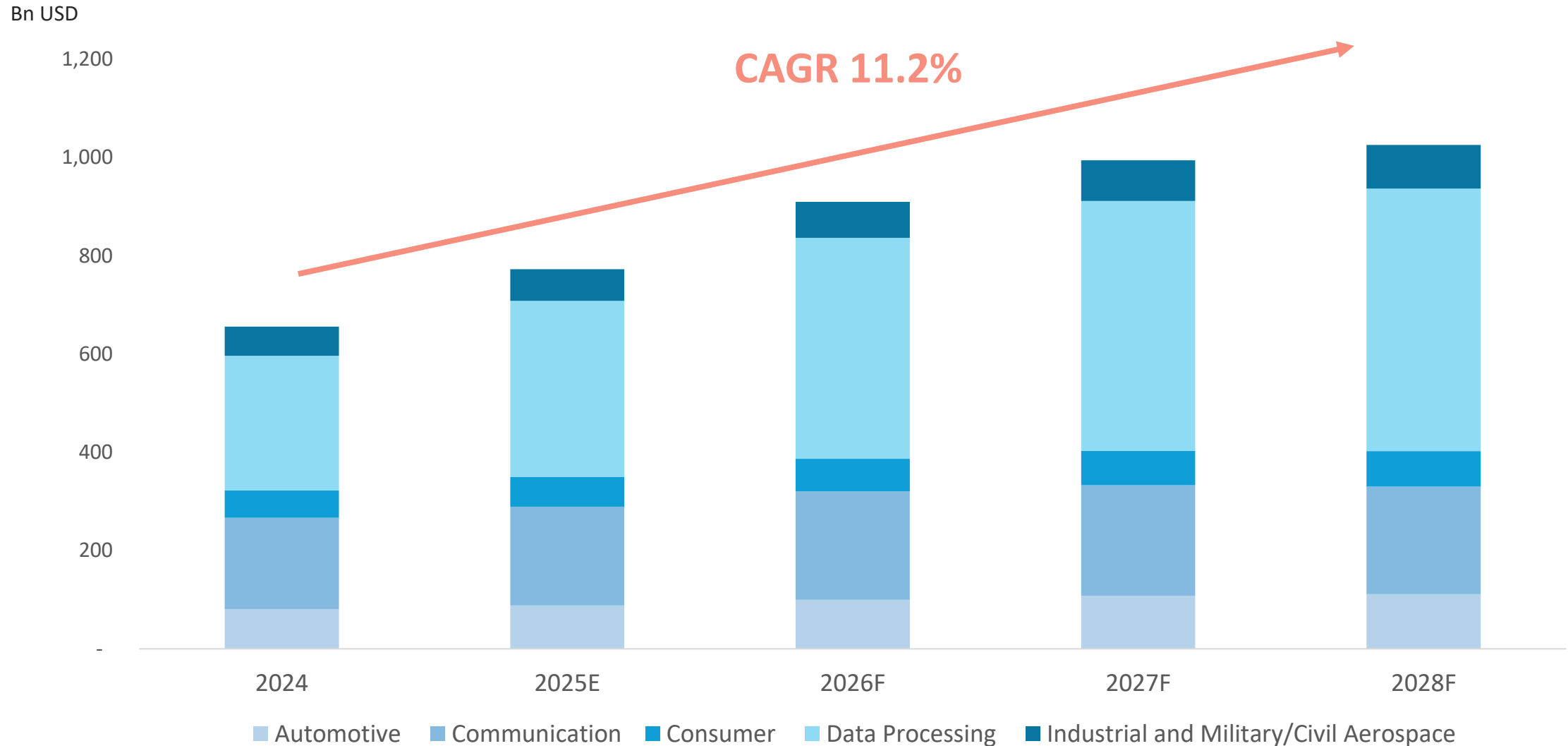


財務指標

Item	2025Q1	2025Q2	2025Q3
晶圓出貨量 (千片十二吋約當晶圓)	2,099	2,292	2,531
營業收入淨額 (美元百萬元)	33	34	38
營業收入淨額 (新台幣百萬元)	1,082	1,044	1,164
營業毛利率	37.3%	32.0%	33.4%
營業淨利率	24.0%	19.7%	20.9%
純益率	21.3%	9.5%	17.3%
每股盈餘 - (新台幣元)	1.34	0.58	1.17
股東權益報酬率 (年化)	21.2%	15.6%	17.8%
營業現金流 (新台幣百萬元)	426	304	261
資本支出 (新台幣百萬元)	-944	-793	-313
自由現金流量 (新台幣百萬元)	-518	-489	-52

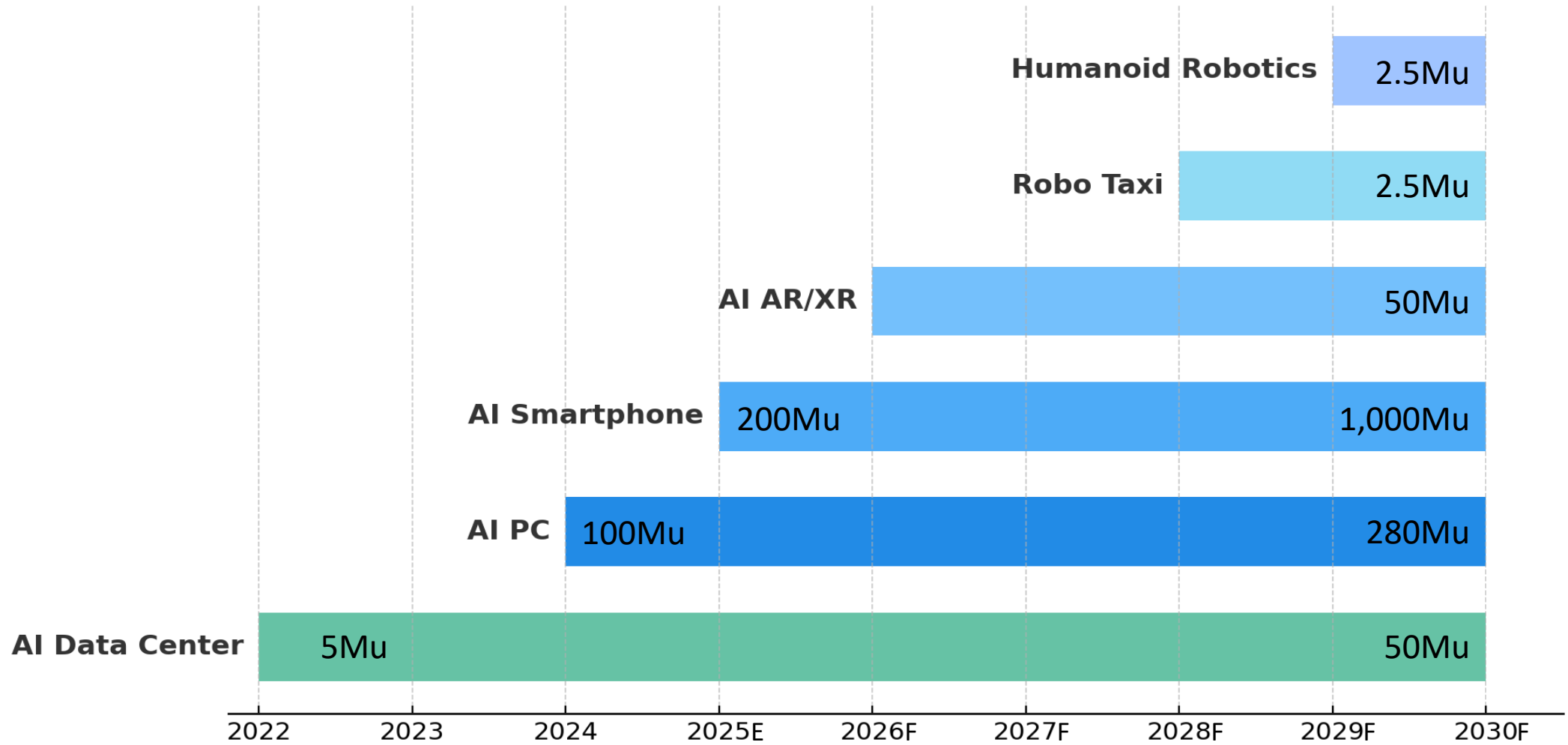
半導體產業展望

AI 推動半導體市場邁向 1 兆美元



Source: Gartner

AI 驅動 從中心雲端至邊緣運算



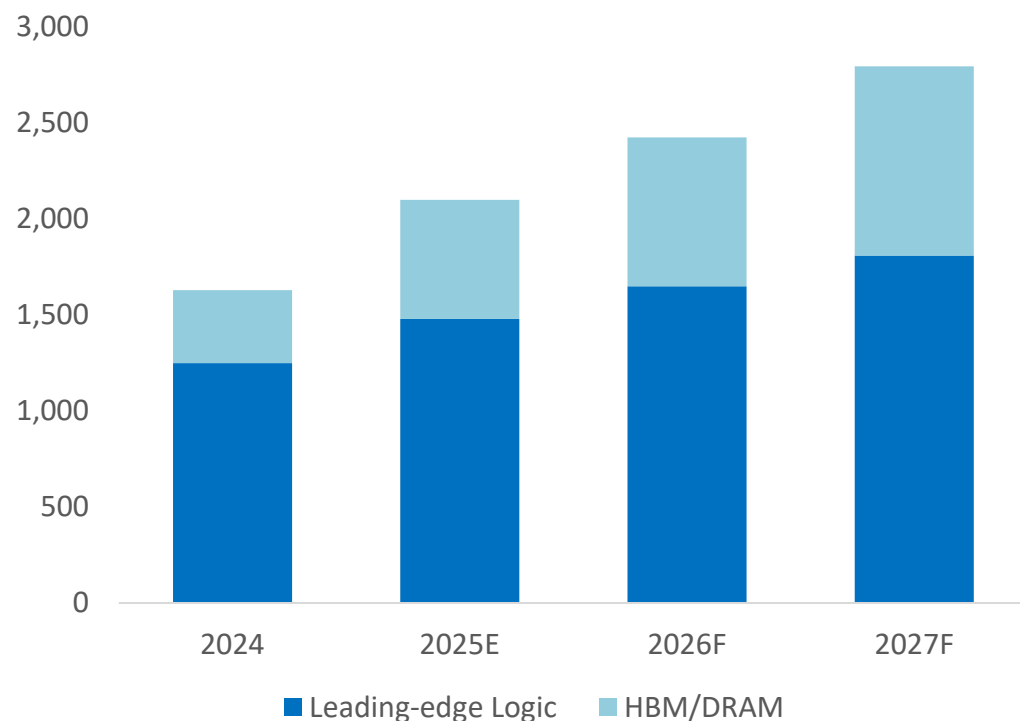
Source: WSTS, IDC, TSMC

再生晶圓成長動力以及市佔率預估

PSI 發展的兩項核心戰略驅動力

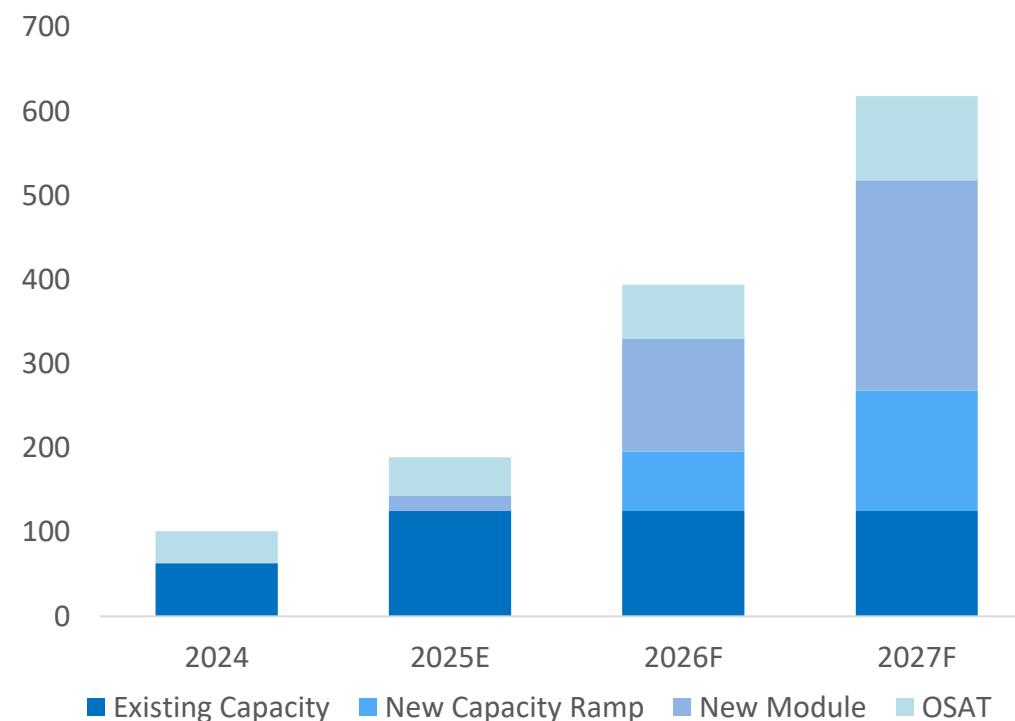
晶片前段製程微縮

Capacity Kwpm



先進封裝產能的規模化部署

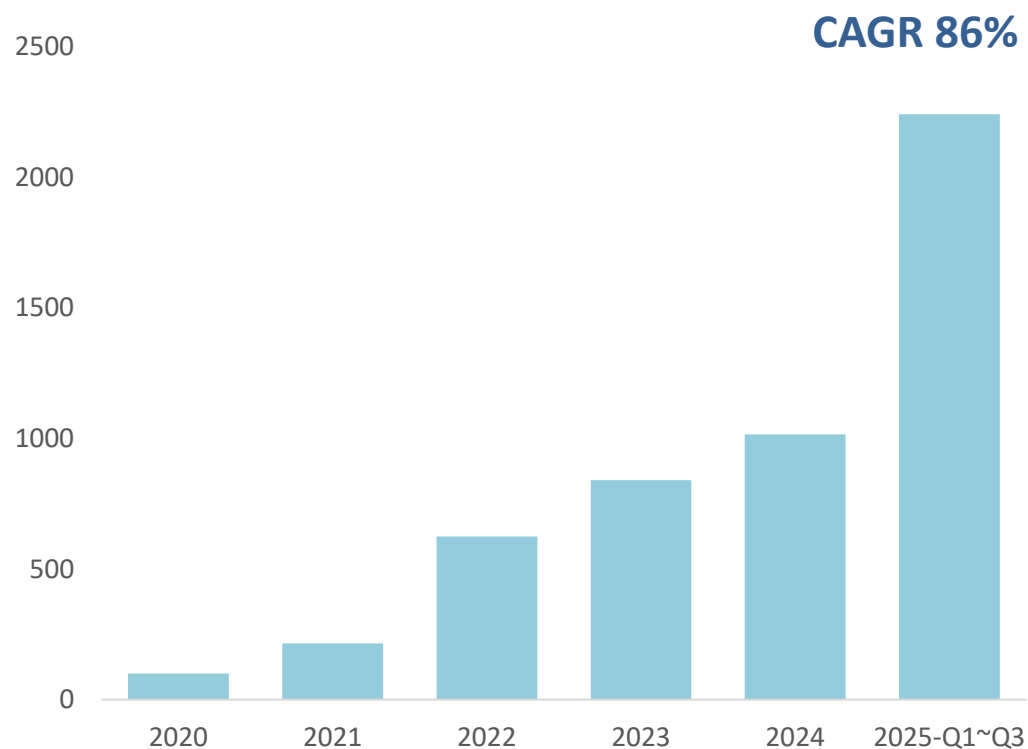
Capacity Index(2024=100)



PSI 的潛力成長新動能

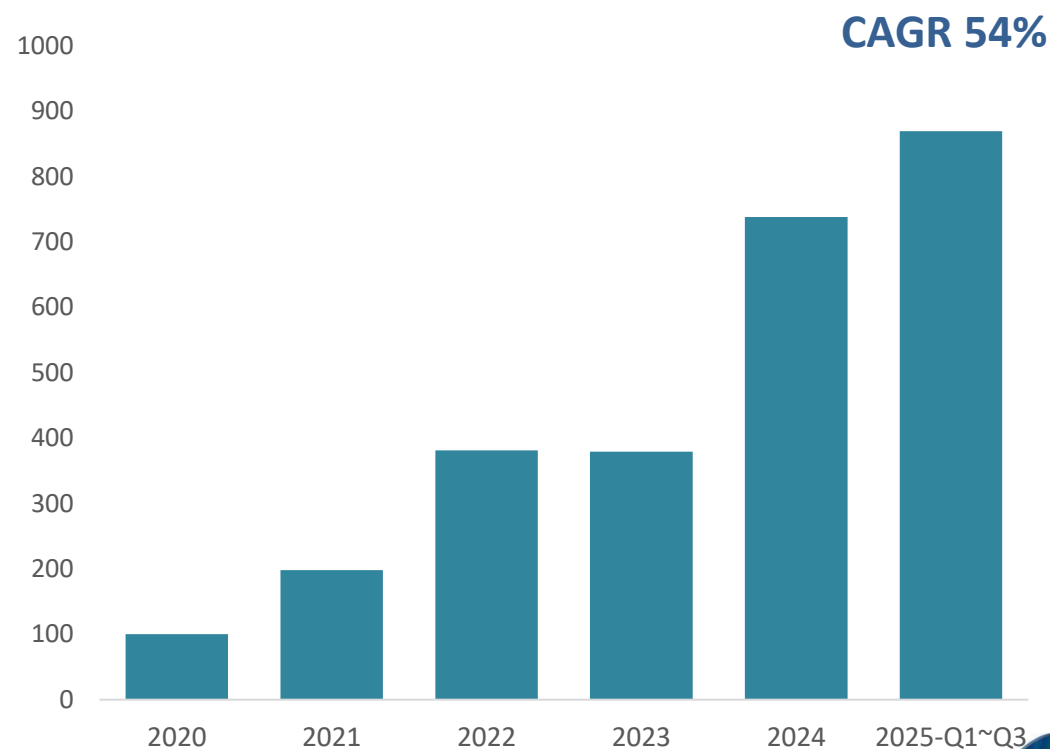
記憶體製程用的再生晶圓

Shipment Index(2020=100)



先進封裝製程用的再生晶圓

Shipment Index(2020=100)



戰略資本支出與未來投資佈局

- **12 吋再生晶圓產能擴張**

前瞻佈局 12 吋再生晶圓產能，確保能高效供應高規格產品，奠定長期訂單的基石。

- **投入碳化矽晶圓製程研發**

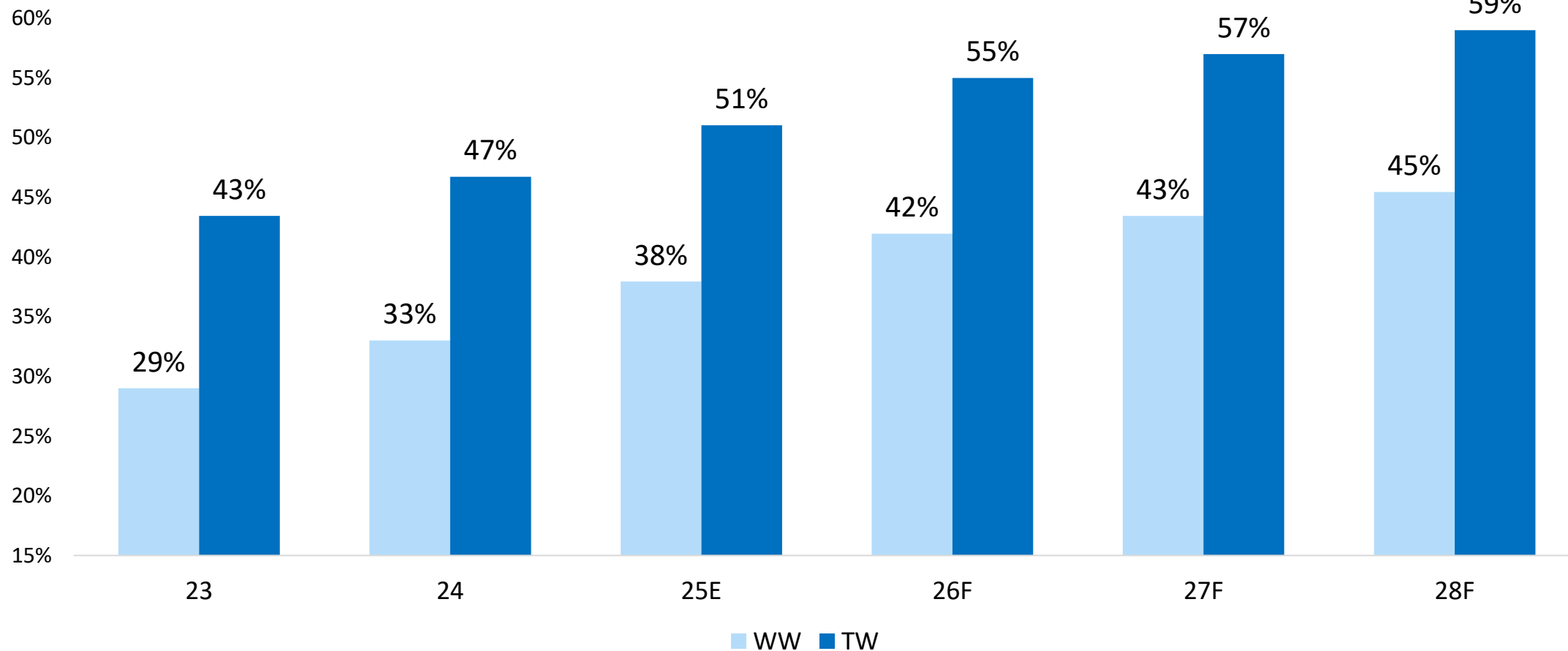
投資 SiC 晶圓製程技術，該技術不僅是 AI 的現在，更是形塑 AI 未來的關鍵。



智慧 規模 永續

快速擴大市佔率

PSI Share %

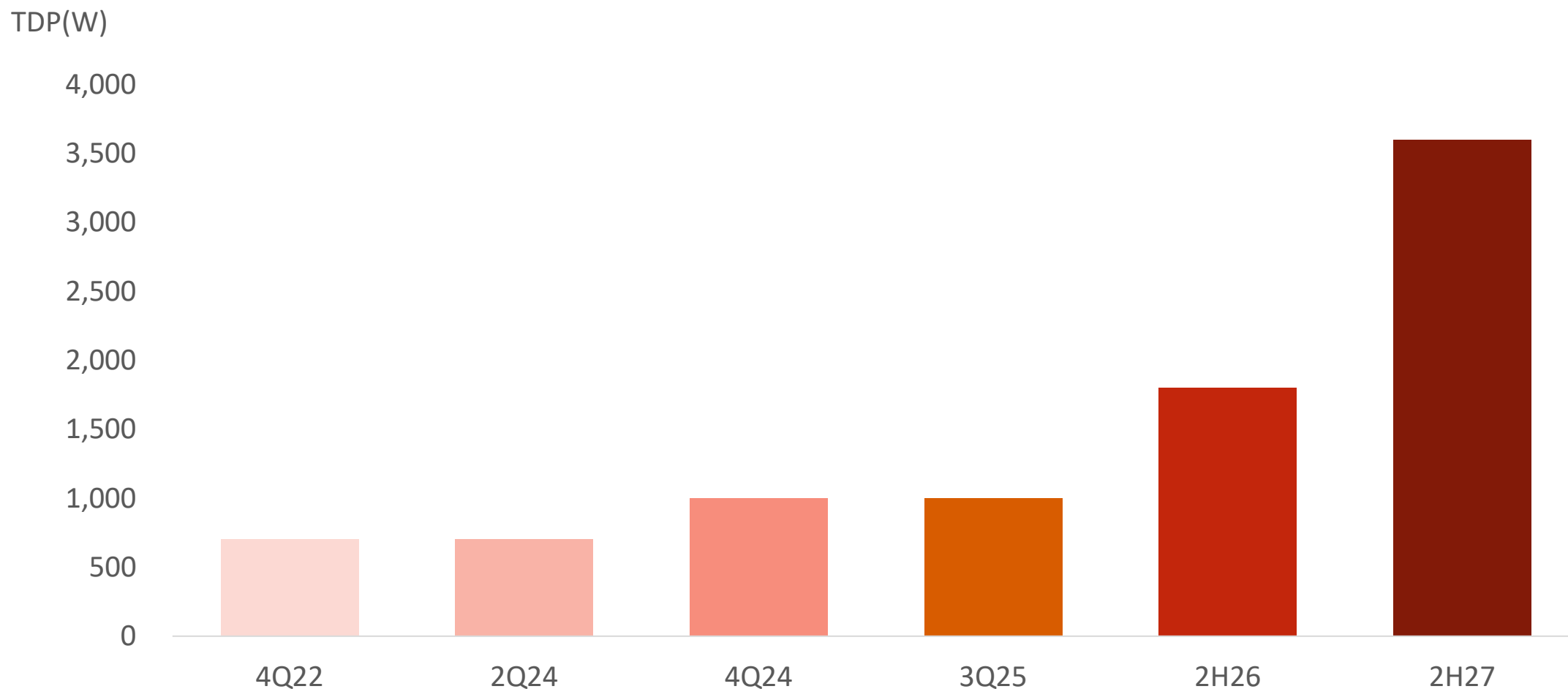


Source: company data, PSI

潛在成長動能 12吋矽與碳化矽

把握功耗與散熱管理的關鍵機遇

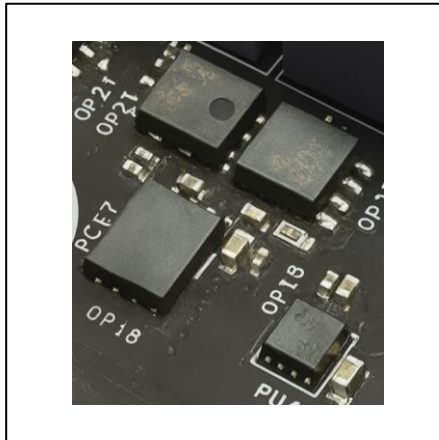
數據中心電力與散熱架構面臨前所未有的考驗



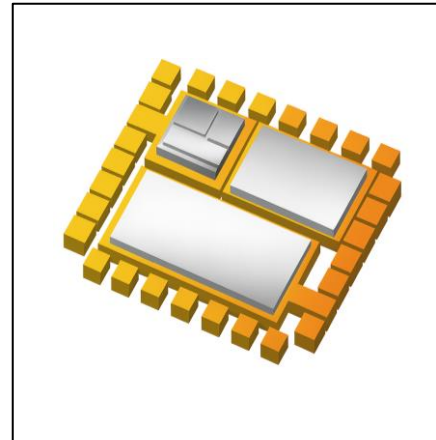
Source: company data, Nomura, GFHK

Dr. MOS 掌握多重市場成長機遇

Traditional Design



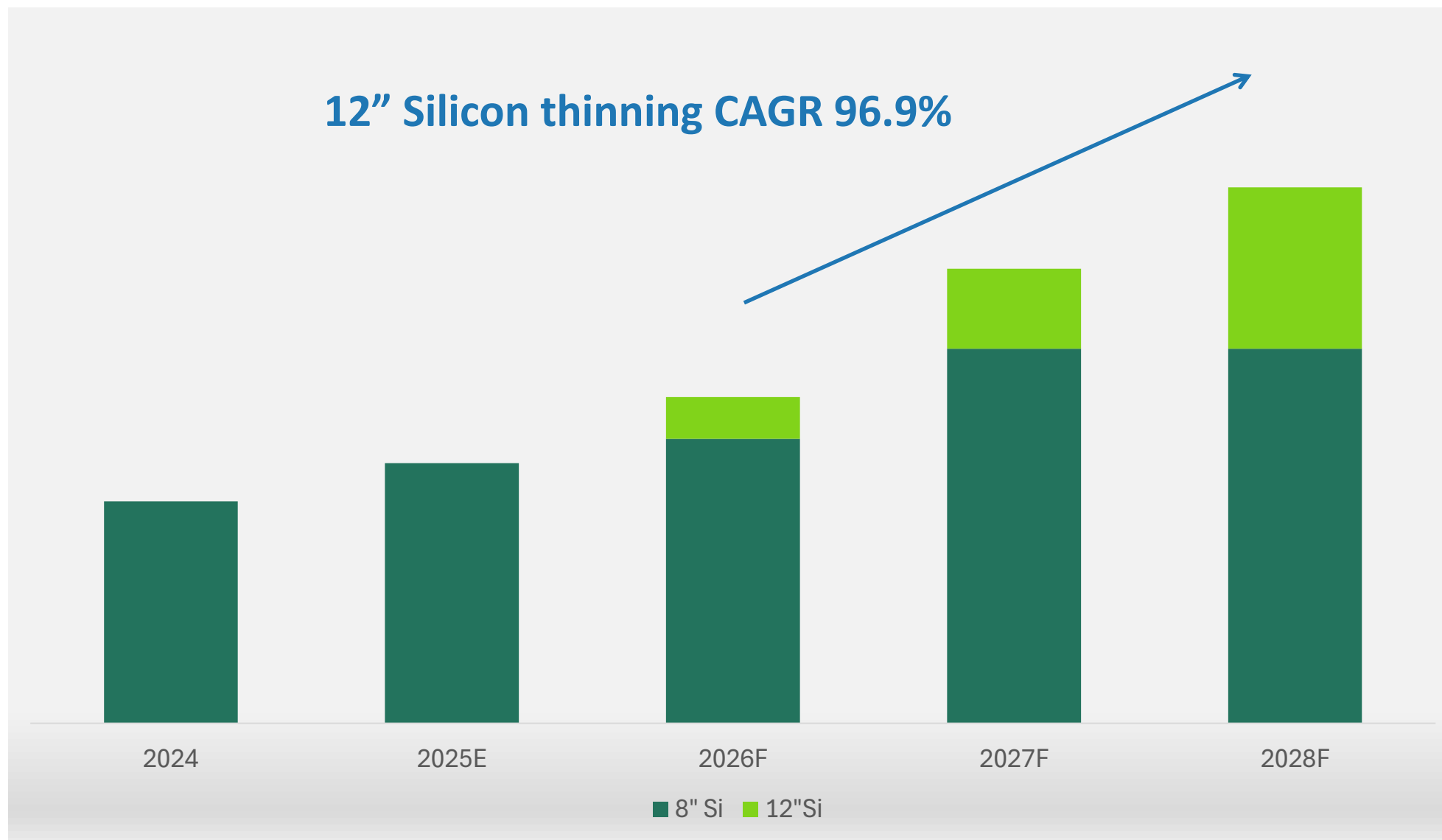
Driver MOSFET



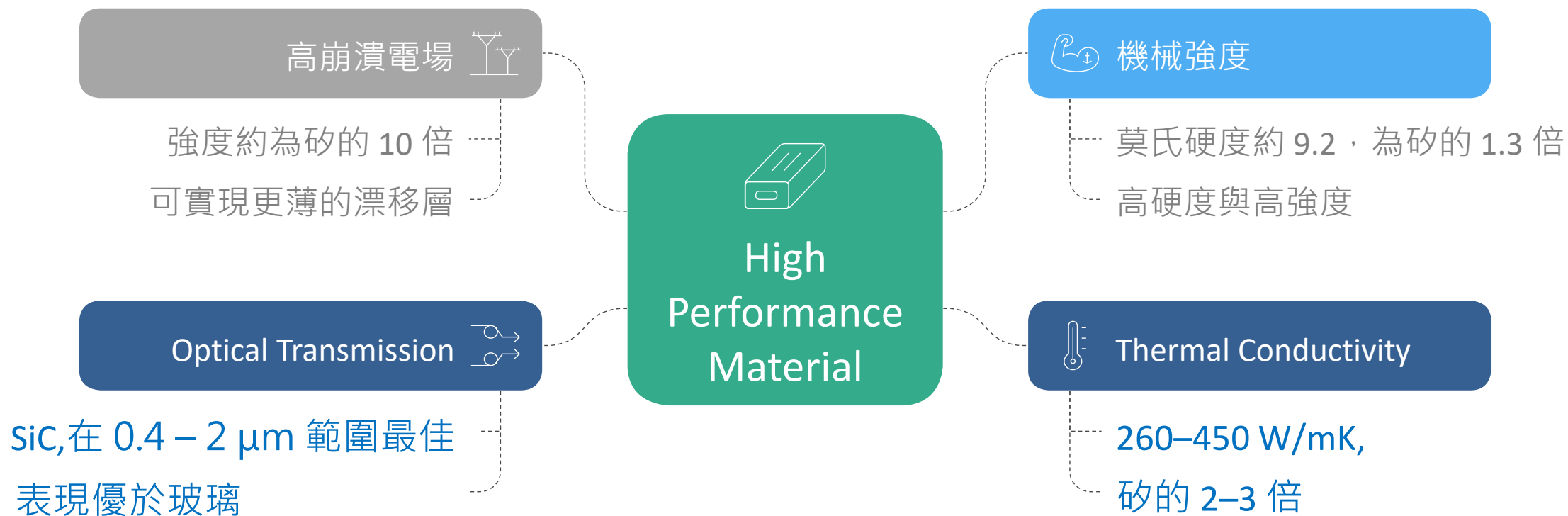
High Density Power Module



擴展 12 吋薄化能力 因應次世代需求



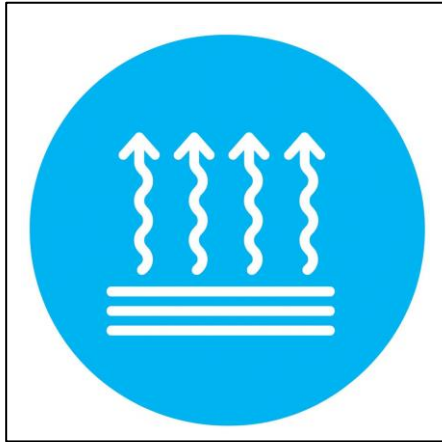
超越矽材料－碳化矽的關鍵特性



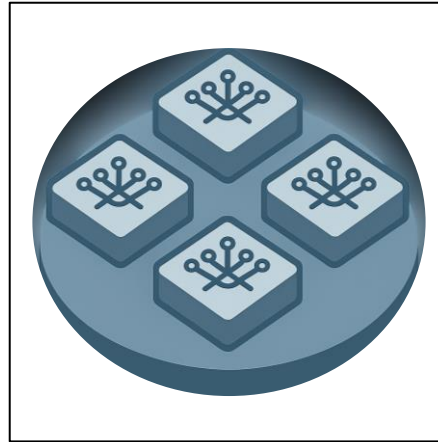
Source: company data, PSI

碳化矽新時代

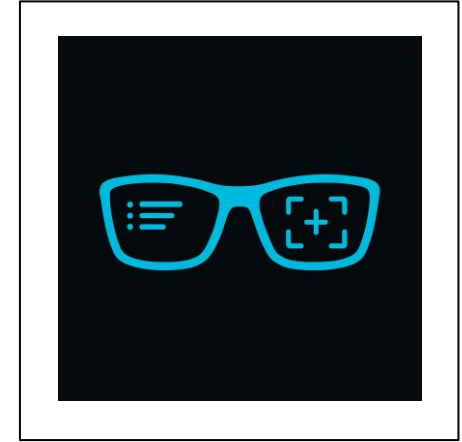
Heat Dissipater



IC Substrate



Specialty glass



長期擴產規劃

Long Term Opportunities

USA

驅動力

- 晶片法案政策驅動
- 縮短交貨期間

策略

- 與在地供應商建立深度合作關係
- 執行價格策略

Taiwan

驅動力

- 持續增長的先進製程和封裝需求
- 專業人才與完整產業生態系統

策略

- 建構 AI 驅動的智慧化晶圓廠
- 即時交付支援

India

驅動力

- 政府的政策推動與扶持
- 全球晶圓廠的投資湧入

策略

- 與在地晶圓廠建立策略合作夥伴關係
- 模組化生產線，實現快速規模擴張

Taiwan Expansion Plan Update

新竹 複合製程基地

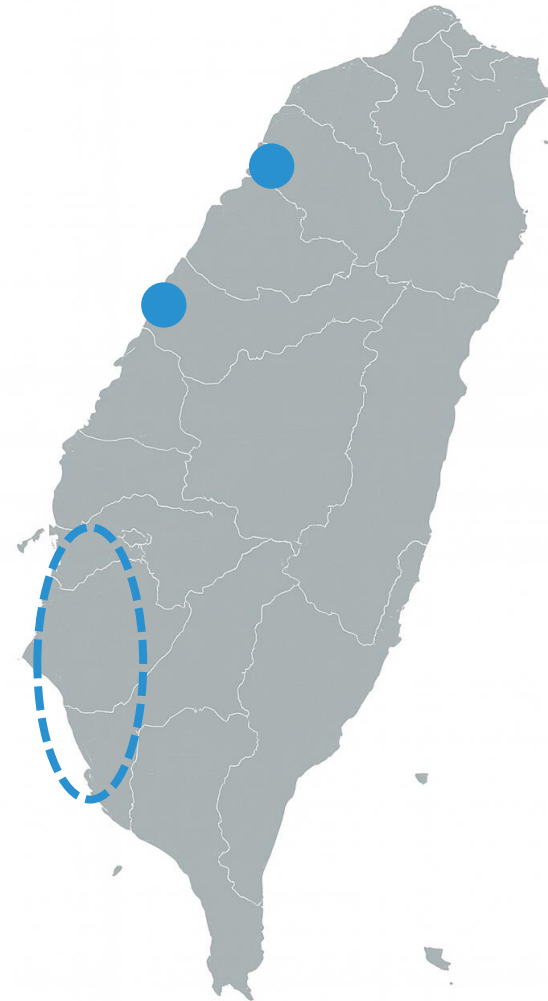
- 1998 年再生晶圓量產
- 2005 年晶圓薄化量產

台中 專用再生晶圓廠

- 2022 年第一座廠量產
- 2025 年起啟動第二座廠建設

南臺灣

- 先進製程製造重鎮
- PSI 正審慎評估可行性



Key Messages From PSI

成長為核心目標 嚴謹紀律為後盾

- AI 應用驅動先進製程與異質封裝，全面推升高規格再生晶圓需求
- 專注 12 吋功率元件薄化及新型導熱介面材料，賦能次世代 AI 產品
- 以創新技術為導向，搭配嚴謹紀律，確保長期獲利與領導地位

[Https://www.psi.com.tw](https://www.psi.com.tw)
ir@psi.com.tw
